

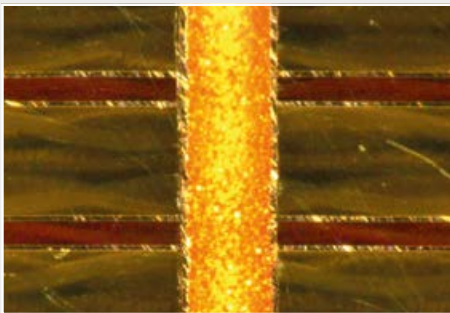
Zuverlässige Durchkontaktierung im Labor

LPKF Contac S4

- Microvia-Reinigungsschritt
- Optionale Verzinnung
- Gleichmäßiger Aufbau der Kupferschicht
- Einfache Bedienung



Sichere Durchkontaktierung im Entwicklungslabor



Nicht nur doppelseitige Leiterplatten, sondern auch die Kerne von Multilayern werden von der LPKF Contac S4 zuverlässig und gleichmäßig durchkontaktiert.

Durchkontaktierung für Labore – LPKF Contac S4 für einen zuverlässigen galvanischen Prozess

Zuverlässige Durchkontaktierung ist ein Schlüssel zum Erfolg bei anspruchsvollen Leiterplatten-Prototypen. Die neue LPKF Contac S4 vereint verschiedene galvanische und chemische Prozesse in einem kompakten Sicherheitsgehäuse.

Galvanische Durchkontaktierung

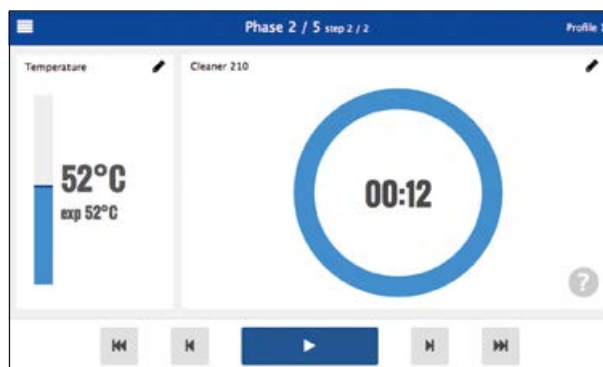
Die Verbindung zweier oder mehrerer Lagen ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Leiterplatten-Prototypings. Die kompakte LPKF Contac S4 mit sechs Bädern übernimmt diese Aufgabe zuverlässig: Die Platine wird durch alle Stufen einer Bäderekaskade geleitet. Auf diese Weise werden homogene Kupferlagen auf den Wandungen aller Durchgangslöcher erzeugt, selbst bei mehrlagigen Platinen. Die Contac S4 bearbeitet bis zu acht Lagen mit einem maximalen Seitenverhältnis von 1:10 (Durchmesser der Bohrung zu Dicke der Leiterplatte). Die LPKF Contac S4 bietet ein abschließendes Zinnbad zum Schutz der Oberfläche und zur Verbesserung der Lötbarkeit.

Verbesserter Aufbau der Kupferschicht

Die leistungsstarke Technik der LPKF Contac S4 verbessert den Aufbau der Kupferschicht. Optimierte Anodenplatten und Reverse Pulse Plating stellen eine gleichmäßige Abscheidung sicher, und die Aktivierung mittels Black-Hole-Technologie, eine integrierte Luftströmung und ein zusätzlicher Prozessschritt zur Reinigung der Durchgangslöcher sorgen sichere Anschlüsse an das Oberflächenkupfer ohne störende Trennschichten. Das Ergebnis sind gleichmäßige Schichtdicken in den Bohrungen und auf der flachen Metalloberfläche des Substrats.

Einfache Anwendung

Das integrierte Touch-Bedienfeld führt auch unerfahrene Anwender mit einem Assistenten und einer Parameterverwaltung sicher durch den Galvanisierungsprozess. Ambitionierte Entwickler können jederzeit angepasste Einstellungen verwenden. Für den Prozess sind keine Chemikalienkenntnisse und Badanalysen erforderlich, das System weist selbständig auf notwendige Wartungsschritte hin. Ein weiteres neues Merkmal ist das chemikalienbeständige Gehäuse mit verbessertem Schutz vor Verfärbung – hohe Funktionalität, gutes Aussehen und Praxistauglichkeit kommen in der Contac S4 zusammen.



Eine neue grafische Benutzeroberfläche führt durch alle Prozessschritte

Technische Daten: LPKF Contac S4	
Max. Materialgröße (X x Y)	230 mm x 330 mm
Max. Layoutbereich (X x Y)	200 mm x 300 mm
Reverse Pulse Plating	Einstellbar
Toleranz	± 2 µm (Kupferbeschichtung)
Minimaler Bohrungsdurchmesser	≥ 0,2 mm
ViaCleaner	Integriert
Chemische Verzinnung	Integriert
Prozesszeit	ca. 90 – 120 min
Elektrische Leistungsaufnahme	110 / 230 V, 50–60 Hz, 0,6 kW
Abmessungen (B x H x T)	856 mm x 446 mm x 542 mm
Gewicht	ca. 80 kg leer, ca. 115 kg befüllt

